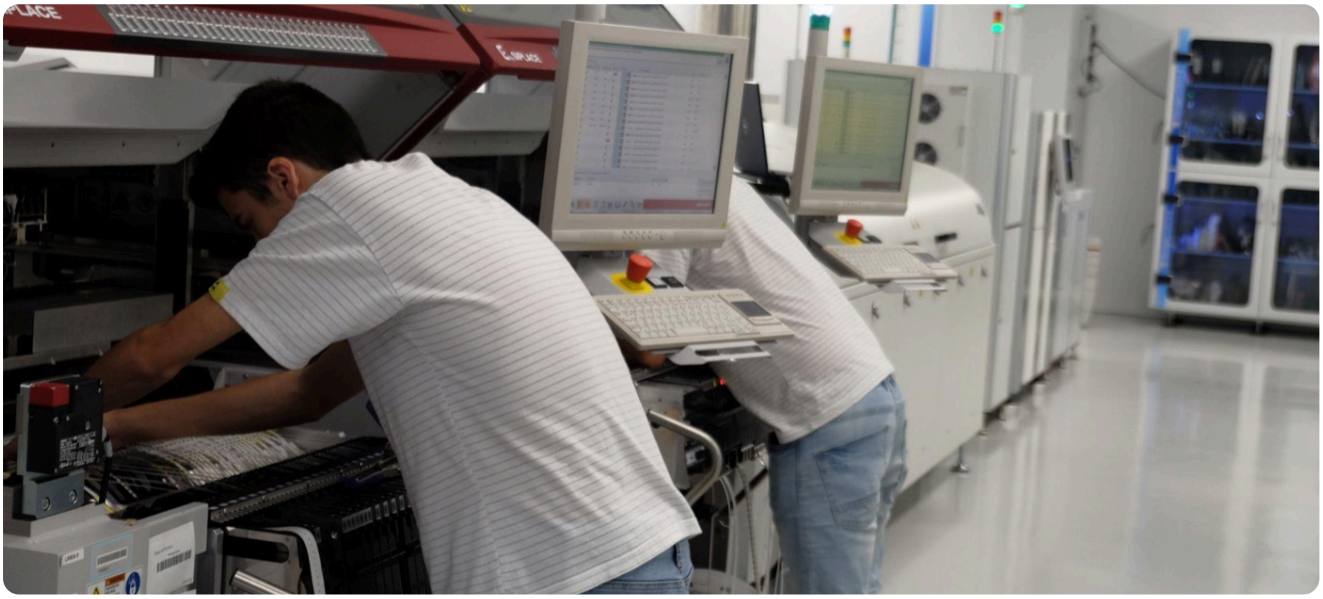
FITXA TÈCNICA · PRODUCCIÓ

Muntatge electrònic amb inspecció i traçabilitat a cada fase.

Partners in technology

Fabriquem PCBA per a tercers, de prototips a grans sèries, en una planta pròpia a Badalona i amb enginyeria al costat de cada projecte.



80.000
col·locacions/h teòriques (20.000–40.000 reals)

400 × 460 mm
panell màxim a la línia SMD (mínim 80 × 80 mm)

0201 → BGA 0,4
de passius 0201 a BGA de 0,4 mm de pas

100 %
de les plaques inspeccionades amb AOI 3D

Qualitat certificada

ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 · IPC-A-610 · RoHS · Sala ESD · 40 % energia solar pròpia

Com treballem

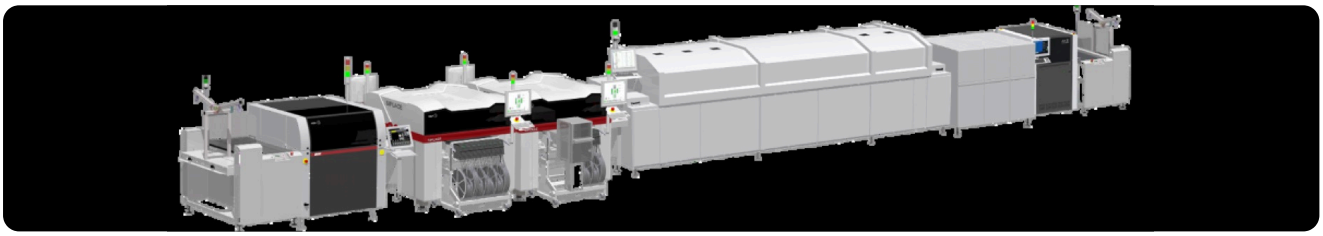
Una sola línia, preparada per a prototips i sèries. Muntem SMD i THT en una sala antiestàtica, amb processos estandarditzats sota ISO 9001 i ISO 13485.

Traçabilitat total. Cada placa porta un codi QR: sabem quins components i lots s'hi han muntat, quan i quins controls ha superat.

Enginyeria al costat. Revisem el disseny pensant en com es fabricarà (DfM) i et proposem alternatives si un component escasseja.

Línia SMD

Línia ASM completa, de la serigrafia a la inspecció final, amb càrrega i descàrrega automàtiques.



Serigrafia	ASM DEK Photon amb inspecció 2D de pasta (SPI) integrada
Pick & Place	2 × ASM Siplace E: SPEED (capçal de 12 pipetes) i FLEX (12 pipetes + PP)
Forn de refusió	SEHO Reflow 2.3, 14 zones (7 + 7), sense plom; perfilador Mole MAP
Inspecció AOI	Omron AOI 3D a la sortida, amb descàrrega automàtica OK / NOK
Manipulació	Multi Magazine Loader, 4 Link Conveyors, Buffer FIFO i Shuttle Unloader

Capacitats

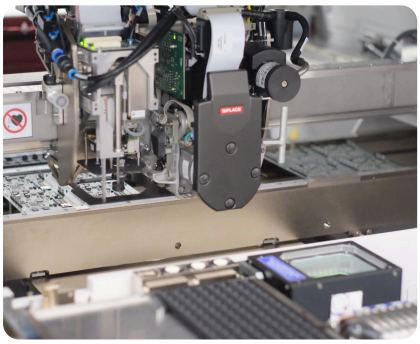
- Components de **0201 a 200 × 125 mm**, fins a 50 mm d'alçada (01005 amb actualització)
- **BGA, *µ*BGA, LGA, CSP** de 0,4 / 0,5 / 0,65 / 0,8 mm de pas · **QFN i QFP** de 0,4 mm
- SOT, TSOP, QSOP, VSOP, PLCC, LQFP i LED
- Visió fine-pitch, control de força de col·locació i de coplanaritat en temps real

Alimentadors i materials

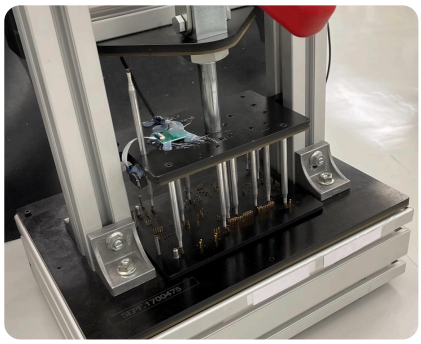
- Bobina: 8, 12, 16, 24, 32 i 44 mm
- Stick: 20 posicions · Safata: 15 safates
- Pastes de soldadura Interflux i Kester
- Dos armaris amb control d'humitat (Essegui) i forn de secat de components

THT, inspecció i test

Soldadura selectiva	ERSA Smartflow 2020, plaques fins a 508 × 508 mm, flux per polvorització i càmera de procés
Raigs X 2D / 3D	Nordson DAGE Quadra 3 Pro, 70 µm/píxel i talls X-Plane: BGA, QFN, curtcircuits, ompliment de PTH i detecció de falsificacions (sota demanda)
AOI 3D	Omron, amb estació de programació fora de línia
ICT i test funcional	Llits de punxes a mida, fabricats amb fresadora CNC pròpia i lector QR que desa els resultats
Flying probe	Servei subcontractat (SPEA 4050 S2): ICT paramètrica sense utillatge
Rework	Estació d'infraroig IR6500 per a BGA i estació d'aire JBC
Protecció	Coating (vernissat) i potting (encapsulat)







Muntatge final i serveis

- Muntatge de conjunts amb **cargolat amb control de força**
- **Marcatge làser** de PCBA, carcasses i etiquetes
- **Cobot** Universal Robots UR3e de suport a l'operari
- Utillatges impresos en 3D (Ultimaker S5)
- Despanelat semiautomàtic per disc (V-cut)
- **Compres, magatzem i picking** de components i producte



Del disseny a la sèrie, sense canviar de proveïdor

Si encara no tens el disseny, també el fem: esquemàtics i PCB, firmware, Embedded Linux, FPGA, Edge AI i connectivitat. El que dissenyem, també ho fabriquem.



Explica'ns el teu projecte

Envia'ns la BOM, els Gerbers i les quantitats, i et preparem el pressupost.

info@dracosystems.net
+34 935 607 010
dracosystems.net